

ANEXO I

a) Incorporar à lista:

NCM 2007	REQUISITO DE ORIGEM
2102.10.10	Mudança de posição tarifária e 60% de valor agregado regional.
2102.10.90	Mudança de posição tarifária e 60% de valor agregado regional.
5603.11.20	Mudança de posição tarifária e 60% de valor agregado regional.
5603.11.30	Mudança de posição tarifária e 60% de valor agregado regional.
5603.11.40	Mudança de posição tarifária e 60% de valor agregado regional.
5603.12.30	Mudança de posição tarifária e 60% de valor agregado regional.
5603.12.40	Mudança de posição tarifária e 60% de valor agregado regional.
5603.12.50	Mudança de posição tarifária e 60% de valor agregado regional.
5603.13.30	Mudança de posição tarifária e 60% de valor agregado regional.
5603.13.40	Mudança de posição tarifária e 60% de valor agregado regional.

5603.13.50	Mudança de posição tarifária e 60% de valor agregado regional.
5603.14.20	Mudança de posição tarifária e 60% de valor agregado regional.
5603.14.30	Mudança de posição tarifária e 60% de valor agregado regional.
5603.14.40	Mudança de posição tarifária e 60% de valor agregado regional.
5603.91.10	Mudança de posição tarifária e 60% de valor agregado regional.
5603.91.20	Mudança de posição tarifária e 60% de valor agregado regional.
5603.91.30	Mudança de posição tarifária e 60% de valor agregado regional.
5603.91.90	Mudança de posição tarifária e 60% de valor agregado regional.
5603.92.20	Mudança de posição tarifária e 60% de valor agregado regional.
5603.92.30	Mudança de posição tarifária e 60% de valor agregado regional.
5603.92.40	Mudança de posição tarifária e 60% de valor agregado regional.
5603.93.20	Mudança de posição tarifária e 60% de valor agregado regional.
5603.93.30	Mudança de posição tarifária e 60% de valor agregado regional.
5603.93.40	Mudança de posição tarifária e 60% de valor agregado regional.

8470.50.11	Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecânicas, totalmente desagregadas, em nível básico de componentes; e C. Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final de acordo com os itens "A" e "B" anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes módulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item 8473.30.22 para impressoras das subposições 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para aparelhos de "fac-símile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Será admitida a utilização de subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a produção dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". Não descaracteriza o comprimento do regime de origem definido, a inclusão em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos e fonte de alimentação.	I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a função de Processamento central (placa principal) ; II- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.
8470.50.19	Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecânicas, totalmente desagregadas, em nível básico de componentes; e C. Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final de acordo com os itens "A" e "B" anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes módulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item 8473.30.22 para impressoras das subposições 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para aparelhos de "fac-símile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Será admitida a utilização de subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a produção dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". Não descaracteriza o comprimento do regime de origem definido, a inclusão em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos e fonte de alimentação.	I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a função de Processamento central (placa principal) ; II- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formatação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.
8471.30.12	MICROCOMPUTADORES PORTÁTEIS. Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso que implementem as funções de processamento e memória, as controladoras de periféricos para teclado, e unidades de discos magnéticos e as interfaces de comunicação serial e paralela, cumulativamente. Quando as unidades centrais de processamento incorporarem no mesmo corpo ou gabinete, placas de circuito impresso que implementem as funções de rede local ou emulação de terminal, estas placas também deverão ter a montagem e soldagem de todos seus componentes; B. Montagem das partes elétricas e mecânicas, totalmente desagregadas, em nível básico de componentes; e C. Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final de acordo com os itens "A" e "B" anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes módulos ou subconjuntos: 1) Tela ("display") dos itens 8473.30.91 e 8473.30.92; e 2) Teclado do item 8471.60.52. Não descaracteriza o cumprimento do regime de origem definido a inclusão em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos e fonte de alimentação.	I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a função de Processamento central (placa principal) ; II- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formatação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.
8471.30.19	MICROCOMPUTADORES PORTÁTEIS. Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso que implementem as funções de processamento e memória, as controladoras de periféricos para teclado, e unidades de discos magnéticos e as interfaces de comunicação serial e paralela, cumulativamente. Quando as unidades centrais de processamento incorporarem no mesmo corpo ou gabinete, placas de circuito impresso que implementem as funções de rede local ou emulação de terminal, estas placas também deverão ter a montagem e soldagem de todos seus componentes; B. Montagem das partes elétricas e mecânicas, totalmente desagregadas, em nível básico de componentes; e C. Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final de acordo com os itens "A" e "B" anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes módulos ou subconjuntos: 1) Tela ("display") dos itens 8473.30.91 e 8473.30.92; e 2) Teclado do item 8471.60.52. Não descaracteriza o cumprimento do regime de origem definido a inclusão em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos e fonte de alimentação.	I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a função de Processamento central (placa principal) ; II- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.
8471.30.90	Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecânicas, totalmente desagregadas, em nível básico de componentes; e C. Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final de acordo com os itens "A" e "B" anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes módulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item 8473.30.22 para impressoras das subposições 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para aparelhos de "fac-símile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Será admitida a utilização de subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a produção dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". Não descaracteriza o comprimento do regime de origem definido, a inclusão em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos e fonte de alimentação.	I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a função de Processamento central (placa principal) ; II- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.
8471.41.90	Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecânicas, totalmente desagregadas, em nível básico de componentes; e C. Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final de acordo com os itens "A" e "B" anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes módulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item 8473.30.22 para impressoras das subposições 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para aparelhos de "fac-símile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Será admitida a utilização de subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a produção dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". Não descaracteriza o comprimento do regime de origem definido, a inclusão em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos e fonte de alimentação.	I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a função de Processamento central (placa principal) ; II- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.
8471.50.10	UNIDADES DIGITAIS DE PROCESSAMENTO DE PEQUENA CAPACIDADE. Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso que implementem as funções de processamento e memória e as seguintes interfaces: em série, paralela, de unidades de discos magnéticos, de teclado e de vídeo, cumulativamente. Quando as unidades centrais de processamento incorporem no mesmo corpo o gabinete placas de circuito impresso que implementem as funções de rede local ou emulação de terminal, estas placas também deverão ter uma montagem e soldagem de todos os componentes.B. Montagem das partes elétricas e mecânicas, totalmente desagregadas, em nível básico de componentes; e C. Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final de acordo com os itens "A" e "B" anteriores. Não descaracteriza o cumprimento do Regime de Origem definido, a inclusão no mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos e fonte de alimentação.Nas unidades digitais de processamento do tipo "diskless", destinadas à interconexão em redes locais, a montagem da placa que implementa a interface de rede local poderá substituir a montagem das placas que implementam as interfases em série, paralela e de unidades de discos magnéticos;	I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a função de Processamento central (placa principal) ; II- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.
8471.50.20	UNIDADES DIGITAIS DE CAPACIDADE MÉDIA E GRANDE. Cumprir com o seguinte processo produtivo:A. Montagem e soldagem de todos os componentes no conjunto de placas de circuito impresso que implementem como mínimo 3 (três) das 5 (cinco) seguintes funções: a) processamento central; b) memória; c) unidade de controle integrada/interface ou controladoras de periféricos; d) suporte e diagnóstico de sistema; e) canal ou interface de comunicação com unidade de entrada e saída de dados e periféricos; ou, alternativamente, a montagem de pelo menos 4 (quatro) placas de circuito impresso que implementem qualquer destas funções; B. Montagem e integração das placas de circuito impresso e dos conjuntos elétricos e mecânicos na formação do produto final; eC. Quando a montagem do produto se realize com conjuntos em forma de gaveta, estes conjuntos deverão ser montados a partir de seus subconjuntos, tais como: fontes de alimentação, placas de circuito impresso e cabos. Quando a empresa opte pela montagem do número de placas de circuito impresso, estabelecido no item "A", no caso de que se utilizem placas que sejam padrões do mercado, como por exemplo, placas de memória do tipo "SIMM" do item 8473.30.42 ou 8473.50.50, será considerada uma placa por função, independentemente da quantidade de placas montadas para implementar a função. Para cumprir com o disposto se admitirá a utilização de subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a produção dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A", "B" e "C". O disposto neste Regime também se aplica às unidades de controle de periféricos, tais como controladores de discos, fitas, impressoras e leitoras ópticas e/ou magnéticas e às expansões das funções mencionadas no item "A", inclusive quando não se apresentem no mesmo corpo ou gabinete das unidades digitais de processamento.	I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a função de Processamento central (placa principal) ; II- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formatação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.

8471.50.30	UNIDADES DIGITAIS DE CAPACIDADE MÉDIA E GRANDE. Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes no conjunto de placas de circuito impresso que implementem como mínimo 3 (três) das 5 (cinco) seguintes funções: a) processamento central; b) memória; c) unidade de controle integrada/interface ou controladores de periféricos; d) suporte e diagnóstico de sistema; e) canal ou interface de comunicação com unidade de entrada e saída de dados e periféricos; ou, alternativamente, a montagem de pelo menos 4 (quatro) placas de circuito impresso que implementem qualquer destas funções; B. Montagem e integração das placas de circuito impresso e dos conjuntos elétricos e mecânicos na formação do produto final; eC. Quando a montagem do produto se realize com conjuntos em forma de gaveta, estes conjuntos deverão ser montados a partir de seus subconjuntos, tais como: fontes de alimentação, placas de circuito impresso e cabos. Quando a empresa opte pela montagem do número de placas de circuito impresso, estabelecido no item "A", no caso de que se utilizem placas que sejam padrões do mercado, como por exemplo, placas de memória do tipo "SIMM" do item 8473.30.42 ou 8473.50.50, será considerada uma placa por função, independentemente da quantidade de placas montadas para implementar a função. Para cumprir com o disposto se admitirá a utilização de subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a produção dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A", "B" e "C". O disposto neste Regime também se aplica às unidades de controle de periféricos, tais como controladores de discos, fitas, impressoras e leitoras ópticas e/ou magnéticas e às expansões das funções mencionadas no item "A", inclusive quando não se apresentem no mesmo corpo ou gabinete das unidades digitais de processamento.	I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a função de Processamento central (placa principal) ; II- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formatação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.
8471.50.40	UNIDADES DIGITAIS DE CAPACIDADE MUITO GRANDE. Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes no conjunto de placas de circuito impresso que implementem pelo menos 2 (duas) das 5 (cinco) seguintes funções: a) processamento central; b) memória; c) unidade de controle integrada/interface; d) suporte e diagnóstico de sistemas; e) canal de comunicação, ou alternativamente, a montagem de pelo menos 3 (três) placas de circuito impresso que implementem qualquer destas funções; B. Montagem e integração das placas de circuito impresso e dos conjuntos elétricos e mecânicos na formação do produto final; eC. Quando a montagem do produto se realize com conjuntos em forma de gaveta, estes conjuntos deverão ser montados a partir de seus subconjuntos, tais como: fontes de alimentação, placas de circuito impresso e cabos. Quando a empresa opte pela montagem do número de placas de circuito impresso, estabelecido no item "A", no caso de que se utilizem placas que sejam padrões do mercado, como por exemplo, placas de memória do tipo "SIMM" do item 8473.30.42 ou 8473.50.50, será considerada uma placa por função, independentemente da quantidade de placas montadas para implementar a função. Para cumprir com o disposto se admitirá a utilização de subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a produção dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A", "B" e "C". O disposto neste Regime também se aplica às unidades de controle de periféricos, tais como controladores de discos, fitas, impressoras e leitoras ópticas e/ou magnéticas e às expansões das funções mencionadas no item "A", inclusive quando não se apresentem no mesmo corpo ou gabinete das unidades digitais de processamento.	I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a função de Processamento central (placa principal) ; II- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formatação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.
8471.50.90	Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecânicas, totalmente desagregadas, em nível básico de componentes; e C. Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final de acordo com os itens "A" e "B" anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes módulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item 8473.30.22 para impressoras das subposições 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para aparelhos de "fac-símile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Será admitida a utilização de subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a produção dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". Não descaracteriza o comprimento do regime de origem definido, a inclusão em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos e fonte de alimentação.	I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a função de Processamento central (placa principal) ; II- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formatação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.
8471.60.52	Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecânicas, totalmente desagregadas, em nível básico de componentes; e C. Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final de acordo com os itens "A" e "B" anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes módulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item 8473.30.22 para impressoras das subposições 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para aparelhos de "fac-símile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Será admitida a utilização de subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a produção dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". Não descaracteriza o comprimento do regime de origem definido, a inclusão em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos e fonte de alimentação.	I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a função de Processamento central (placa principal) ; II- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formatação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.
8471.60.53	Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecânicas, totalmente desagregadas, em nível básico de componentes; e C. Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final de acordo com os itens "A" e "B" anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes módulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item 8473.30.22 para impressoras das subposições 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para aparelhos de "fac-símile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Será admitida a utilização de subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a produção dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". Não descaracteriza o comprimento do regime de origem definido, a inclusão em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos e fonte de alimentação.	I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a função de Processamento central (placa principal) ; II- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formatação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.
8471.60.59	Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecânicas, totalmente desagregadas, em nível básico de componentes; e C. Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final de acordo com os itens "A" e "B" anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes módulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item 8473.30.22 para impressoras das subposições 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para aparelhos de "fac-símile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Será admitida a utilização de subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a produção dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". Não descaracteriza o comprimento do regime de origem definido, a inclusão em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos e fonte de alimentação.	I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a função de Processamento central (placa principal) ; II- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formatação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.
8471.60.61	Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecânicas, totalmente desagregadas, em nível básico de componentes; e C. Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final de acordo com os itens "A" e "B" anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes módulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item 8473.30.22 para impressoras das subposições 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para aparelhos de "fac-símile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Será admitida a utilização de subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a produção dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". Não descaracteriza o comprimento do regime de origem definido, a inclusão em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos e fonte de alimentação.	I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a função de Processamento central (placa principal) ; II- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formatação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.
8471.60.62	Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecânicas, totalmente desagregadas, em nível básico de componentes; e C. Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final de acordo com os itens "A" e "B" anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes módulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item 8473.30.22 para impressoras das subposições 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para aparelhos de "fac-símile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Será admitida a utilização de subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a produção dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". Não descaracteriza o comprimento do regime de origem definido, a inclusão em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos e fonte de alimentação.	I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a função de Processamento central (placa principal) ; II- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formatação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.
8471.60.80	Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecânicas, totalmente desagregadas, em nível básico de componentes; e C. Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final de acordo com os itens "A" e "B" anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes módulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item 8473.30.22 para impressoras das subposições 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para aparelhos de "fac-símile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Será admitida a utilização de subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a produção dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". Não descaracteriza o comprimento do regime de origem definido, a inclusão em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos e fonte de alimentação.	I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a função de Processamento central (placa principal) ; II- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formatação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.

[illegible]

descaracteriza o comprimento do regime de origem definido, a inclusão em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos e fonte de alimentação.

8517.12.11	<p>Mudança de posição e cumprimento do seguinte processo produtivo: A - Montagem de no mínimo 80% das placas de circuito impresso por produto; B - Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecânicas totalmente desagregadas em nível básico de componentes; eD - Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final.</p>	<p>I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a função de Processamento central (placa principal) ; II- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formatação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.</p>
------------	--	--

[illegible]

[illegible]

[illegible]

8517.62.65	Cumprimento do seguinte processo produtivo: A - Montagem de no mínimo 80% das placas de circuito impresso por produto; B - Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecânicas totalmente desagregadas em nível básico de componentes; eD - Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final.	I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a função de Processamento central (placa principal) ; II- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formatação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.
8517.62.71	Mudança de posição e cumprimento do seguinte processo produtivo: A - Montagem de no mínimo 80% das placas de circuito impresso por produto; B - Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecânicas totalmente desagregadas em nível básico de componentes; eD - Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final.	I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a função de Processamento central (placa principal) ; II- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formatação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.
8517.62.72	Mudança de posição e cumprimento do seguinte processo produtivo: A - Montagem de no mínimo 80% das placas de circuito impresso por produto; B - Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecânicas totalmente desagregadas em nível básico de componentes; eD - Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final.	I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a função de Processamento central (placa principal) ; II- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formatação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.
8517.62.79	Mudança de posição e cumprimento do seguinte processo produtivo: A - Montagem de no mínimo 80% das placas de circuito impresso por produto; B - Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecânicas totalmente desagregadas em nível básico de componentes; eD - Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final.	I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a função de Processamento central (placa principal) ; II- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formatação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.
8517.62.91	Mudança de posição e cumprimento do seguinte processo produtivo: A - Montagem de no mínimo 80% das placas de circuito impresso por produto; B - Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecânicas totalmente desagregadas em nível básico de componentes; eD - Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final.	I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a função de Processamento central (placa principal) ; II- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formatação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.
8517.62.93	Mudança de posição e cumprimento do seguinte processo produtivo: A - Montagem de no mínimo 80% das placas de circuito impresso por produto; B - Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecânicas totalmente desagregadas em nível básico de componentes; eD - Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final.	I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a função de Processamento central (placa principal) ; II- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formatação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.
8517.62.94	Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecânicas, totalmente desagregadas, em nível básico de componentes; e C. Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final de acordo com os itens "A" e "B" anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes módulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item 8473.30.22 para impressoras das subposições 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para aparelhos de "fac-símile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Será admitida a utilização de subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a produção dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". Não descaracteriza o cumprimento do regime de origem definido, a inclusão em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos e fonte de alimentação.	I.- Montagem e soldagem de todos os componentes em no mínimo 80% das placas de circuito impresso por produto; II.- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formatação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.
8517.62.95	Mudança de posição e cumprimento do seguinte processo produtivo: A - Montagem de no mínimo 80% das placas de circuito impresso por produto; B - Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecânicas totalmente desagregadas em nível básico de componentes; eD - Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final.	I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a função de Processamento central (placa principal) ; II- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formatação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.
8517.62.96	Mudança de posição e cumprimento do seguinte processo produtivo: A - Montagem de no mínimo 80% das placas de circuito impresso por produto; B - Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecânicas totalmente desagregadas em nível básico de componentes; eD - Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final.	I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a função de Processamento central (placa principal) ; II- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formatação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.
8517.70.10	Circuitos impressos montados com componentes elétricos ou eletrônicos. Montagem e soldagem nas placas de circuito impresso de todos os componentes, sempre que estes não partam da subposição 8473.30	I.- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso; II.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.
8523.52.00	COMPONENTES SEMICONDUTORES E DISPOSITIVOS OPTOELETRÔNICOS. Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem da pastilha semicondutora não encapsulada;B. Encapsulamento da pastilha montada; C. Teste (ensaio) elétrico ou optoeletrônico; D. Marcação (identificação);E. Os circuitos integrados bipolares com tecnologia maior que cinco micrômetros (micra) e os diodos de potência deverão também realizar ou processamento físico-químico da pastilha semicondutora; e F. Os circuitos integrados monolíticos projetados em algum dos Estados Partes ficam dispensados de realizar as etapas "A" e "B" anteriores.	I.- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso; II.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.
8523.59.10	Mudança de posição e cumprimento do seguinte processo produtivo: A - Montagem de no mínimo 80% das placas de circuito impresso por produto; B - Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecânicas totalmente desagregadas em nível básico de componentes; eD - Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final.	I.- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso; II.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.
8525.50.19	Mudança de posição e cumprimento do seguinte processo produtivo: A - Montagem de no mínimo 80% das placas de circuito impresso por produto; B - Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecânicas totalmente desagregadas em nível básico de componentes; eD - Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final.	I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a função de Processamento central (placa principal) ; II- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formatação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.
8525.50.29	Mudança de posição e cumprimento do seguinte processo produtivo: A - Montagem de no mínimo 80% das placas de circuito impresso por produto; B - Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecânicas totalmente desagregadas em nível básico de componentes; eD - Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final.	I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a função de Processamento central (placa principal) ; II- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formatação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

b) incorporar à lista

NCM 2007	REQUISITO DE ORIGEM
8443.31.11	I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a função de Processamento central (placa principal); II- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formatação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.
8443.31.12	I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a função de Processamento central (placa principal) ; II- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formatação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.
8443.31.13	I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a função de Processamento central (placa principal) ; II- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formatação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

9026.10.11	Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecânicas, totalmente desagregadas, em nível básico de componentes; e C. Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final de acordo com os itens "A" e "B" anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes módulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item 8473.30.22 para impressoras das subposições 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para aparelhos de "fac-símile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Será admitida a utilização de subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a produção dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". Não descaracteriza o comprimento do regime de origem definido, a inclusão em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos e fonte de alimentação.
9028.30.11	Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecânicas, totalmente desagregadas, em nível básico de componentes; e C. Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final de acordo com os itens "A" e "B" anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes módulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item 8473.30.22 para impressoras das subposições 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para aparelhos de "fac-símile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Será admitida a utilização de subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a produção dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". Não descaracteriza o comprimento do regime de origem definido, a inclusão em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos e fonte de alimentação.
9028.30.21	Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecânicas, totalmente desagregadas, em nível básico de componentes; e C. Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final de acordo com os itens "A" e "B" anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes módulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item 8473.30.22 para impressoras das subposições 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para aparelhos de "fac-símile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Será admitida a utilização de subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a produção dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". Não descaracteriza o comprimento do regime de origem definido, a inclusão em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos e fonte de alimentação.
9028.30.31	Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecânicas, totalmente desagregadas, em nível básico de componentes; e C. Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final de acordo com os itens "A" e "B" anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes módulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item 8473.30.22 para impressoras das subposições 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para aparelhos de "fac-símile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Será admitida a utilização de subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a produção dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". Não descaracteriza o comprimento do regime de origem definido, a inclusão em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos e fonte de alimentação.